

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年11月3日(03.11.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/230646 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/005 (2012.01) B24B 49/12 (2006.01)
B24B 37/30 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
B24B 49/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/017484

(22) 国際出願日: 2022年4月11日(11.04.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-076022 2021年4月28日(28.04.2021) JP
特願 2021-076023 2021年4月28日(28.04.2021) JP
特願 2022-046364 2022年3月23日(23.03.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).

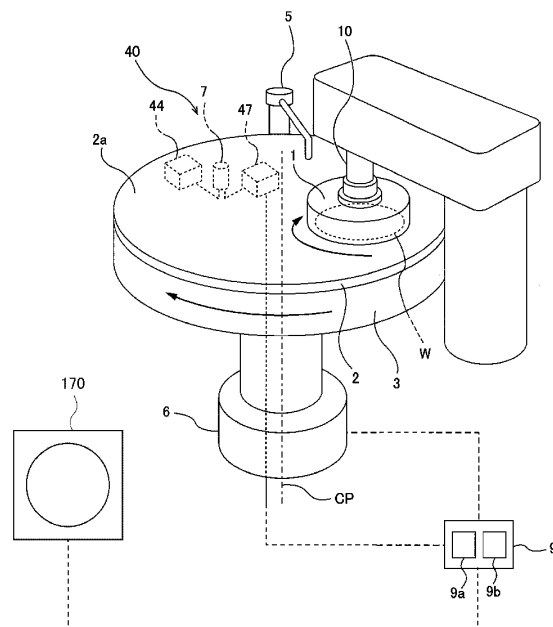
(72) 発明者: 大田 真朗 (OTA, Shinro); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: POLISHING DEVICE AND POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨装置および研磨方法



(57) Abstract: The present invention relates to a polishing device and a polishing method. A polishing device comprises an operation control unit (9) for individually controlling the pressure of each of a plurality of pressure chambers. The operation control unit (9) controls the pressure in the pressure chamber of a polishing head (1) corresponding to a specific position so as to reduce the difference between a film thickness value to be controlled and an average film thickness value of an entire substrate.

(57) 要約: 本発明は、研磨装置および研磨方法に関するものである。研磨装置は、複数の圧力室のそれぞれの圧力を個別に制御する動作制御部(9)を備える。動作制御部(9)は、制御対象膜厚値と基板の全体の平均膜厚値との差分が低減されるように、特定位置に対応する研磨ヘッド(1)の圧力室内の圧力を制御する。

WO 2022/230646 A1

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))